

2009年3月期 中間決算説明会

2008年10月29日

東京エレクトロン デバイス株式会社



東京エレクトロン デバイス株式会社

業績

Technical Support
Development

(単位:百万円)

	2008年3月期		2009年3月期		増減率 (%)
	中間	百分比%	中間	百分比%	
売上高	53,789	100.0	52,432	100.0	2.5%
売上総利益	8,175	15.2	8,336	15.9	2.0%
営業利益	1,836	3.4	1,593	3.0	13.2%
経常利益	1,825	3.4	1,508	2.9	17.3%
当期純利益	1,060	2.0	731	1.4	31.0%
1株当たり中間純利益	10,006.16円		6,904.91円		
R O E	10.4 %		6.7%		
従業員数	774人		830人		

資産

Technical Support
Development

(単位:百万円)

科目	2008年 3月31日現在	2008年 9月30日現在	増減額
現預金	1,367	1,420	53
受取手形・売掛金	25,633	20,774	4,859
たな卸資産	17,649	20,272	2,622
その他流動資産	2,354	3,020	665
有形固定資産	1,012	1,193	180
無形固定資産	785	719	65
投資その他の資産	2,654	2,646	7
資産計	51,458	50,047	1,411

負債・純資産

(単位:百万円)

科目	2008年 3月31日現在	2008年 9月30日現在	増減額
買掛金	13,897	13,377	520
短期借入金	6,069	4,747	1,322
その他流動負債	5,616	5,372	244
固定負債	4,269	4,534	264
負債計	29,853	28,030	1,822
資本金	2,495	2,495	-
資本剰余金	5,645	5,645	-
利益剰余金	13,438	13,816	377
評価・換算差額等	25	59	34
純資産計	21,604	22,016	411
負債・純資産計	51,458	50,047	1,411

キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

	2008年3月期 中 間	2009年3月期 中 間	増減額
営業キャッシュ・フロー	1,508	2,159	650
投資キャッシュ・フロー	501	499	1
財務キャッシュ・フロー	911	1,687	776
現金及び現金同等物 中間期末残高	1,235	1,420	184

セグメント別売上高

(単位:百万円)

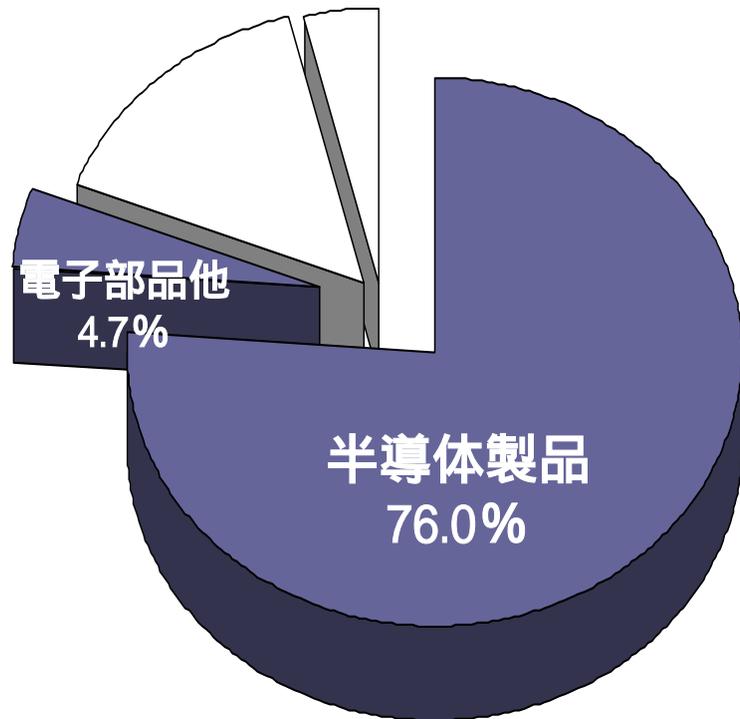
セグメント	従来区分	2008年3月期 中間		2009年3月期 中間		増減率 (%)
		売上高	構成比 (%)	売上高	構成比 (%)	
半導体及び 電子デバイス事業	半導体製品	39,626	73.6	39,832	76.0	0.5
	電子部品他	2,733	5.1	2,480	4.7	9.3
コンピュータシステム 関連事業	コンピュータ・ ネットワーク機器	8,700	16.2	8,106	15.5	6.8
	ソフトウェア	2,729	5.1	2,013	3.8	26.2
合 計		53,789	100.0	52,432	100.0	2.5

* セグメント、従来区分についての説明は、P.29 ~ P.31をご参照ください。

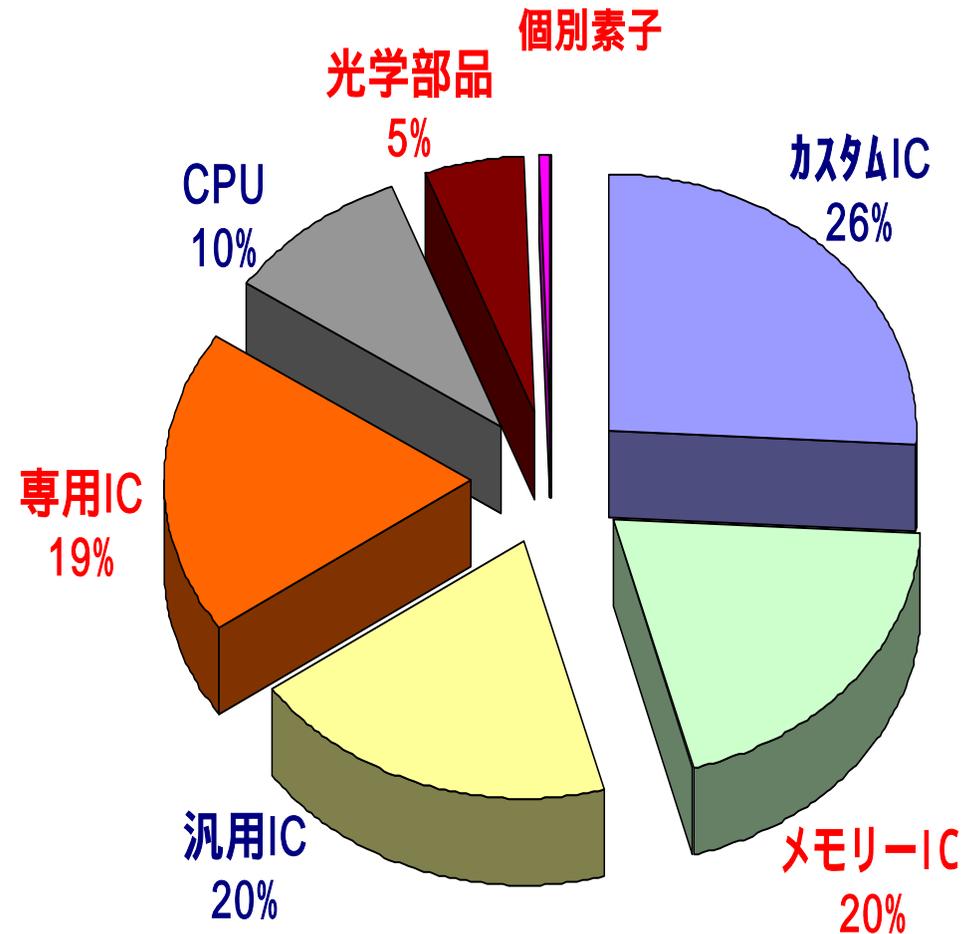
半導体及び電子デバイス事業について

半導体製品売上構成

< 売上構成 >



< 半導体製品内訳 >



* 半導体製品についての説明は、P.29～ P.30をご参照ください。

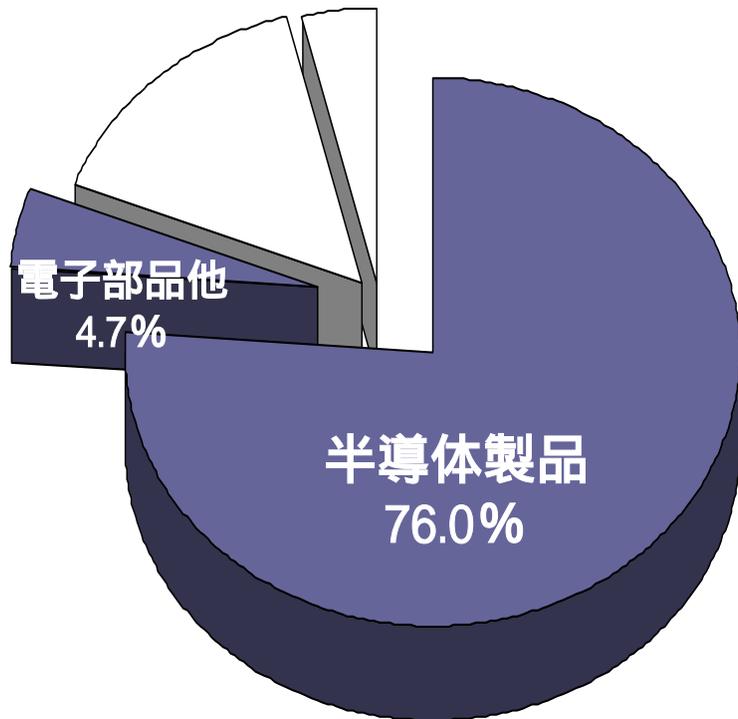
半導体製品 売上増減要因

半導体製品	主な仕入先	対前年増減率	主な増減要因
カスタムIC	ザ・リンクス、富士通	10%	FPGAが携帯電話基地局向け回復
メモリーIC	富士通	9%	フラッシュメモリが携帯電話向け減少
汎用IC	リニアテクノロジー、TI	11%	アナログICが全ての分野で伸長、商権拡大
専用IC	ピクセルワークス	12%	プロジェクタ向け、プリンタ向け減少
CPU	フリースケール 富士通、TI	12%	携帯電話基地局向け、プリンタ向け伸長
光学部品	アバゴ・テクノロジー	3%	車載向け伸長も携帯電話向け減少

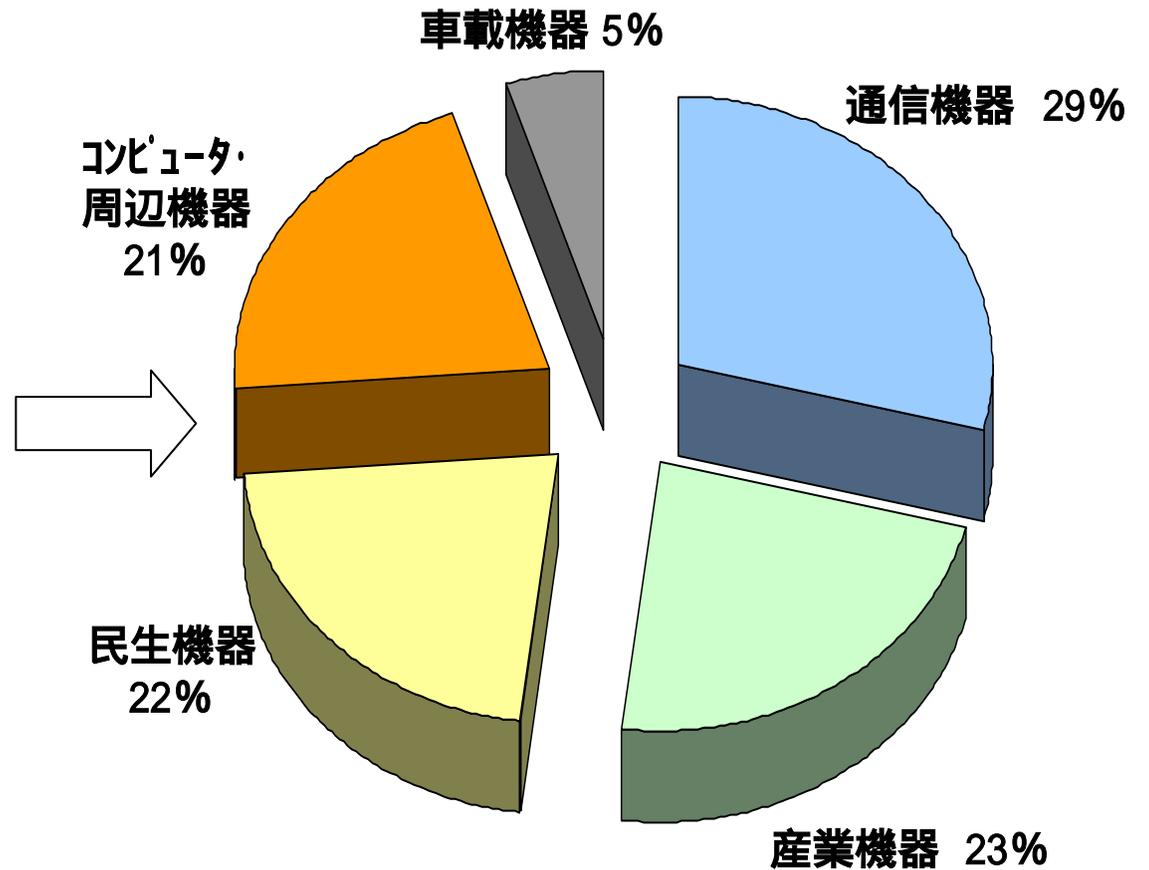
注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

用途別売上構成

< 売上構成 >



< 用途別内訳 >



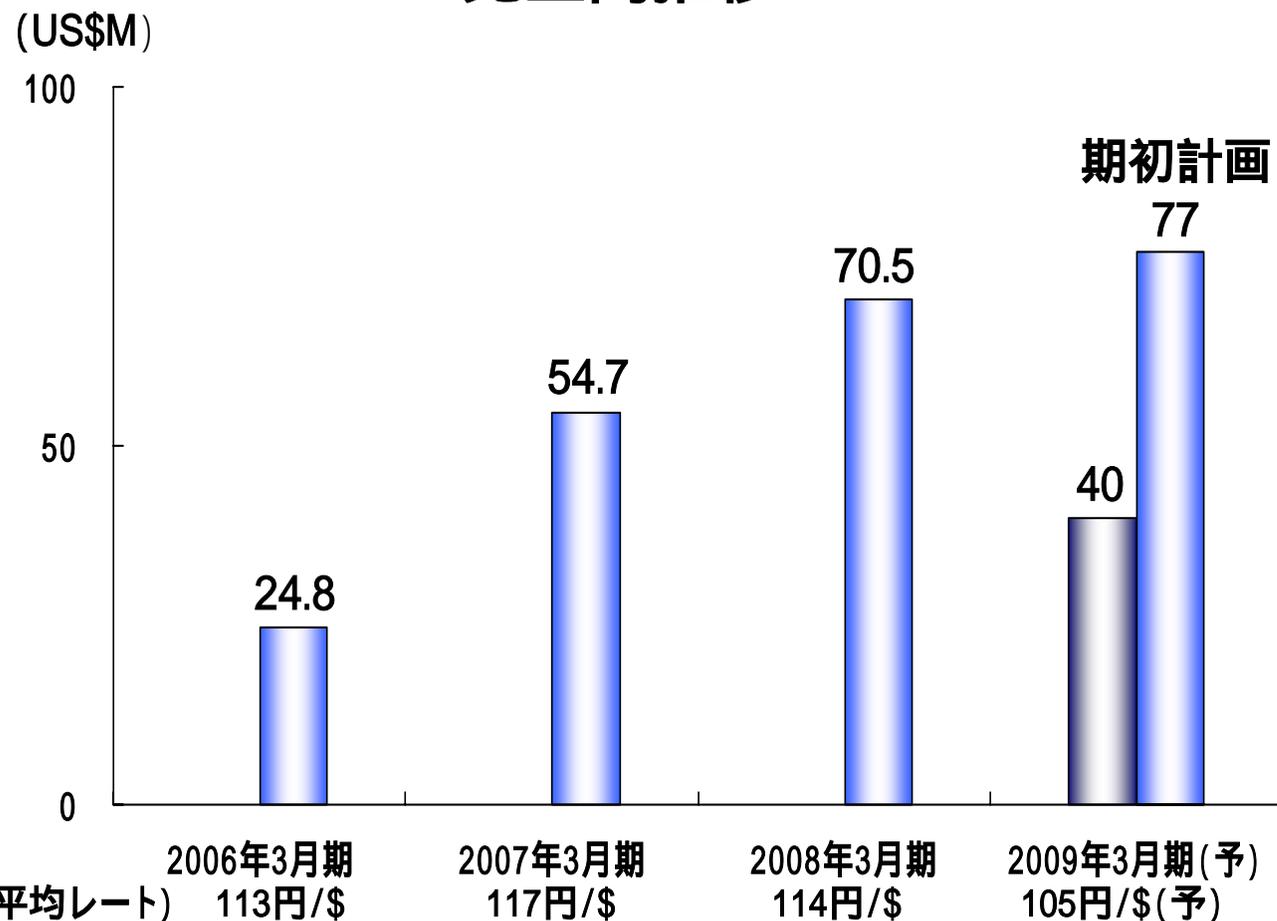
用途別傾向

用途	主なアプリケーション	中間期 主な傾向
通信機器	携帯電話、ルーター、伝送装置、 基地局	携帯電話基地局回復 携帯電話低調
産業機器	医療機器、計測器、放送機器、 半導体装置関連、FA機器	医療機器堅調 半導体装置関連低調
民生機器	デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、 薄型TV、AV機器	デジタル家電総じて低調
コンピュータ・ 周辺機器	プリンター、液晶プロジェクタ、POS PC及び付属機器	PC好調 液晶プロジェクタ低調
車載機器	カーナビゲーション、カーオーディオ	カーナビゲーション好調

海外ビジネスについて

- ・ 中間売上高：40百万ドル

< 売上高推移 >



< 営業拠点 >

香港、上海、大連、シンガポール

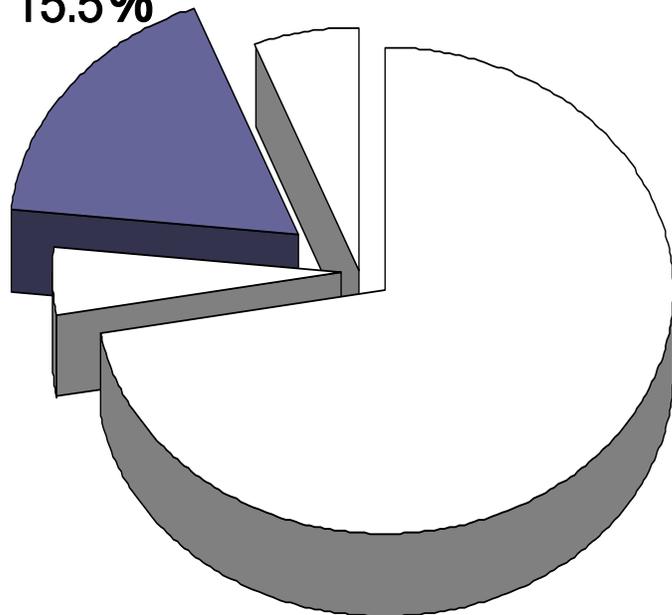


コンピュータシステム関連事業について

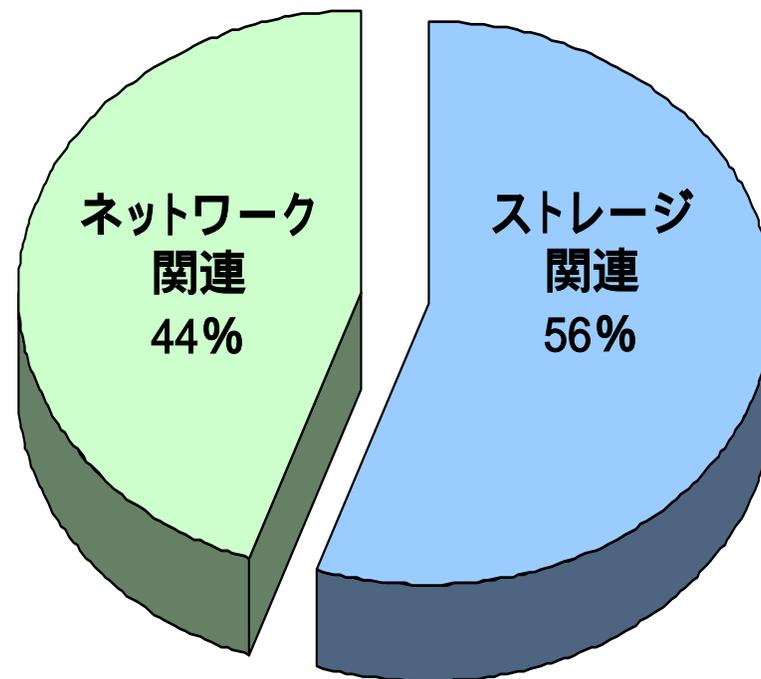
コンピュータ・ネットワーク機器 売上構成

< 品目別売上構成 >

コンピュータ・ネットワーク機器
81億円
15.5%

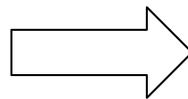
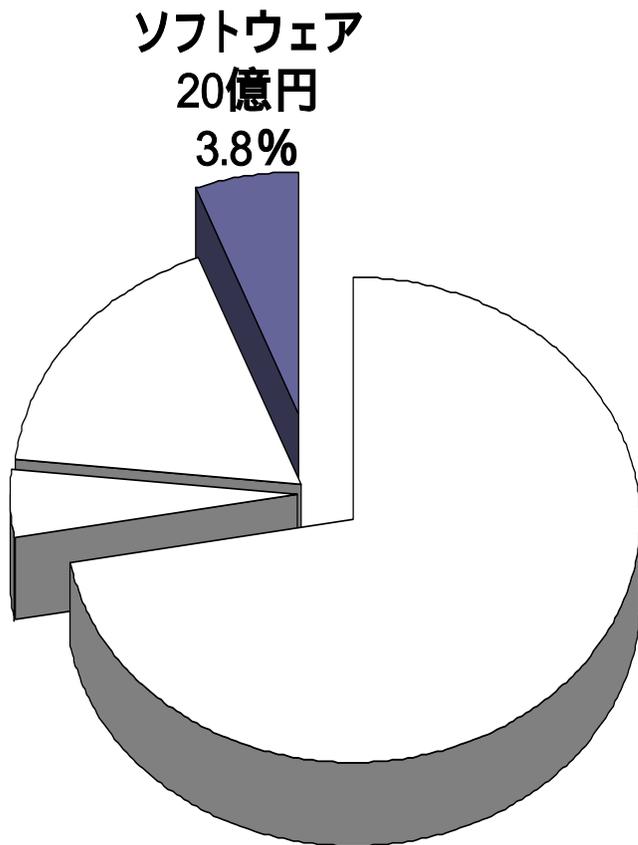


< 分野別内訳 >

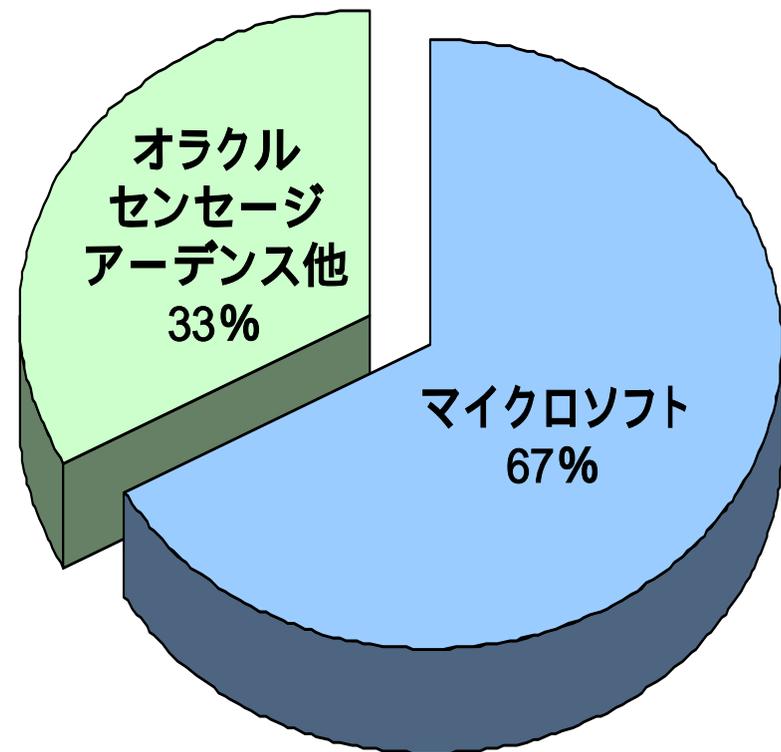


ソフトウェア 売上構成

< 品目別売上構成 >



< 商品別内訳 >



注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

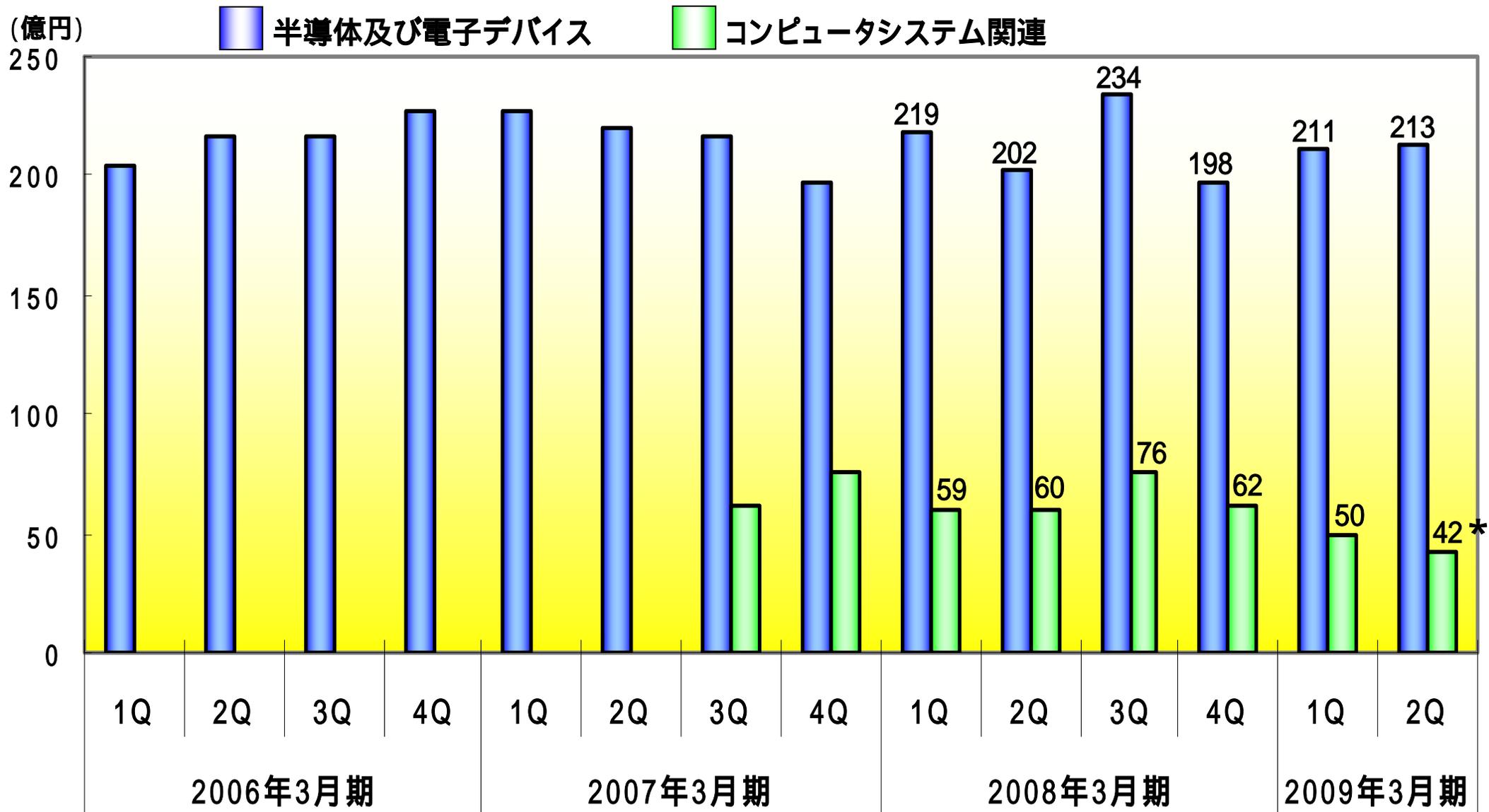
売上増減要因

コンピュータシステム 関連事業	主要仕入先	対前年 増減率	要 因
ストレージ関連	ブロード エミュックス	13%	SANスイッチが金融機関向け減少
ネットワーク関連	F5ネットワークス エクストリーム	3%	インターネット接続機器堅調
ソフトウェア	マイクロソフト オラクル センセージ	26%	POS、ATM向け減少 データベース、ログ解析低調

注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

今期の業績予想について

受注高推移



(*)ソフトウェアの一部を純額表示に変更しております。変更前受注高:48億円。

< 半導体及び電子デバイス事業 >

- ・ マクロ景気の悪化が半導体市場にも波及
- ・ 半導体商社が選別される中、商権増加傾向

< コンピュータシステム関連事業 >

- ・ 企業の情報システム投資は減速

2009年3月期 連結業績予想

(単位:百万円)

	年初对外発表			修正对外発表			通期 増減額
	上期	下期	通期	上期 実績	下期 修正	通期 修正	
売上高	54,600	60,400	115,000	52,432	51,568	104,000	11,000
営業利益	1,560	2,745	4,305	1,593	1,737	3,330	975
経常利益	1,410	2,610	4,020	1,508	1,592	3,100	920
当期純利益	715	1,495	2,210	731	939	1,670	540
1株当たり 配当金	3,300円	3,300円	6,600円	3,300円	3,300円	6,600円	-

2009年3月期 セグメント別売上高予想

(単位:百万円)

セグメント	従来区分	中間実績	下期予想	通期予想	構成比 (%)
半導体及び 電子デバイス事業	半導体製品	39,832	38,868	78,700	75.7
	電子部品他	2,480	2,200	4,680	4.5
コンピュータシステム 関連事業	コンピュータ・ ネットワーク機器	8,106	8,200	16,306	15.7
	ソフトウェア	2,013	2,300	4,314	4.1
合 計		52,432	51,568	104,000	100.0

2009年3月期の活動方針

1. 半導体製品、電子部品他

- ・ 産業機器分野への販売強化
- ・ 海外事業展開の推進

2. コンピュータ・ネットワーク機器

- ・ インテグレーションビジネスの推進

3. ソフトウェア

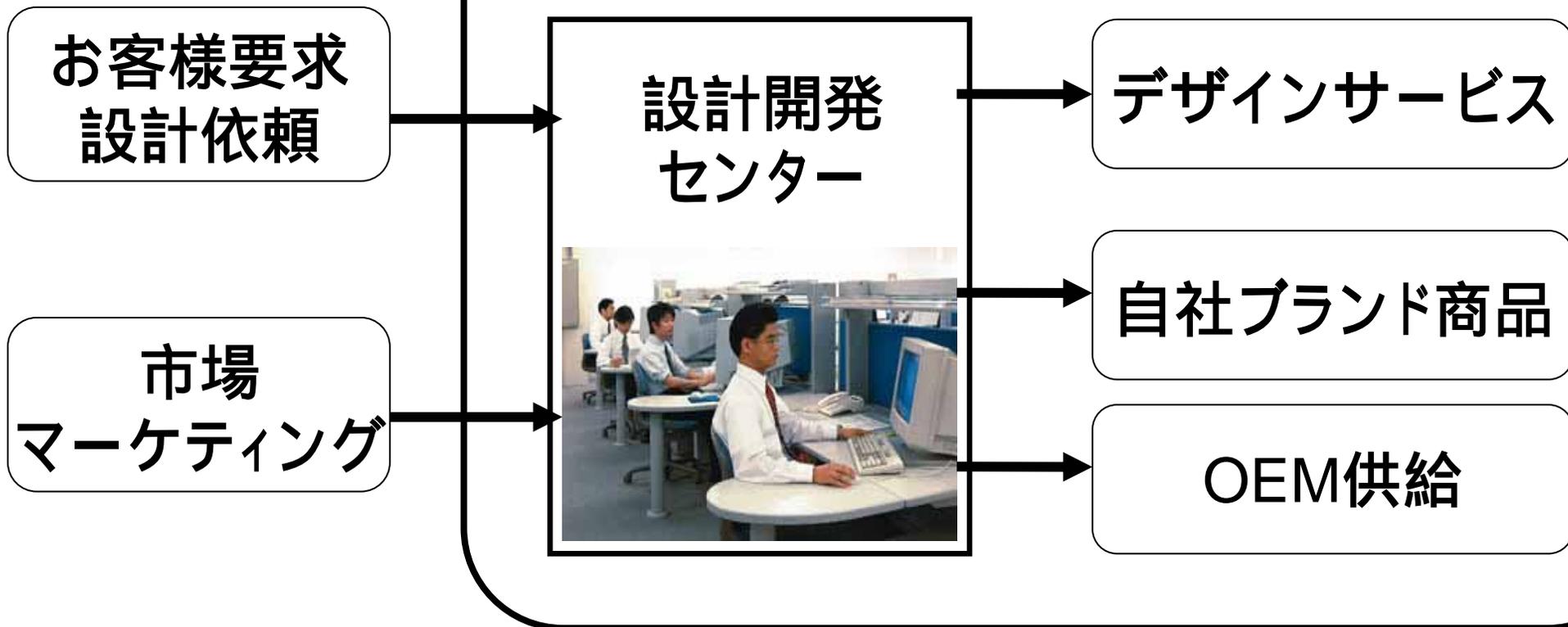
- ・ セキュリティ分野向け拡販

4. 開発ビジネス(インレピアム)

開発ビジネスについて

inrevium

開発ビジネス (インレビウム ビジネス)



デザインサービス

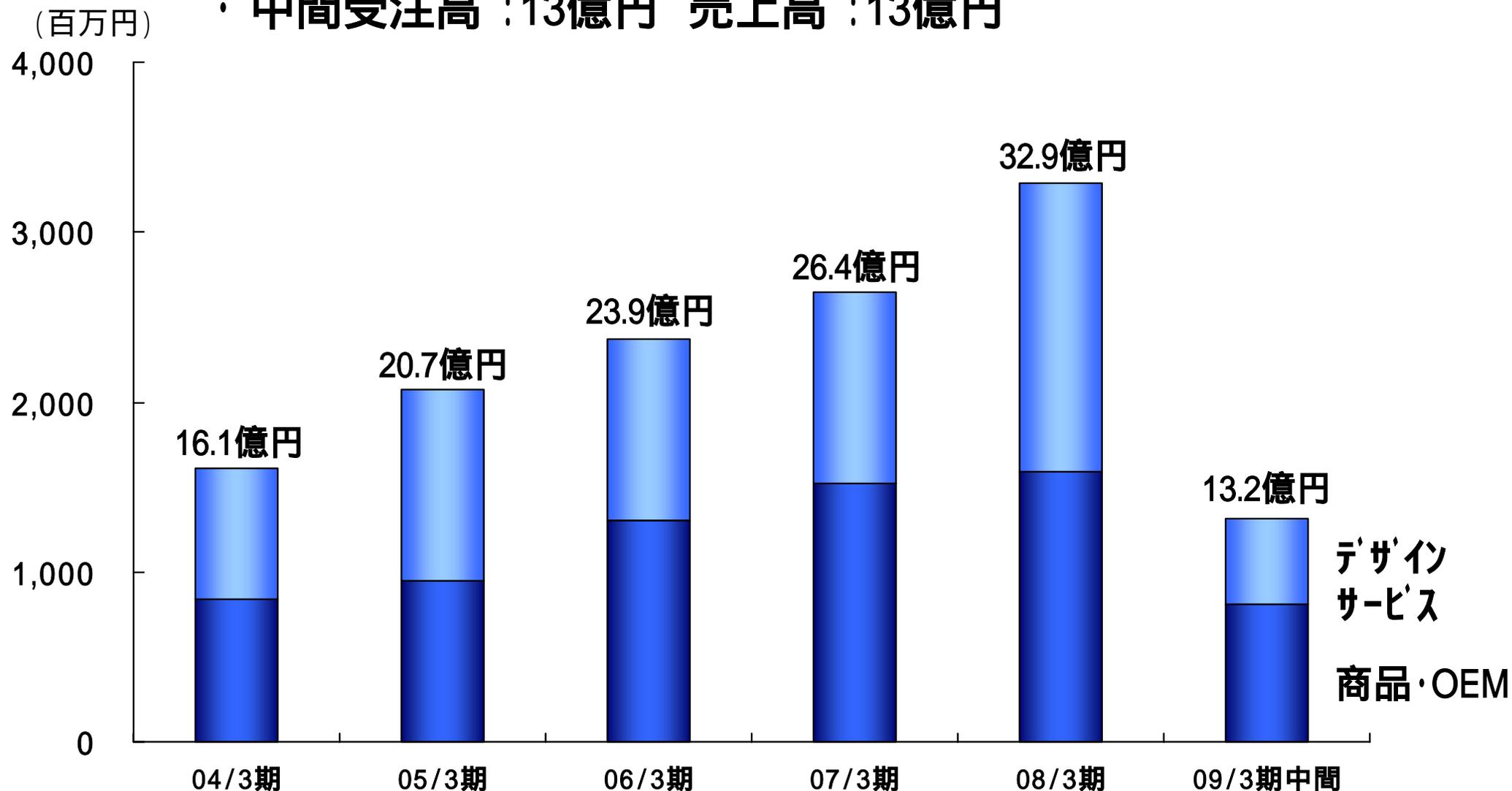
- ・ ソフトウェアを含めたシステム設計の強化

自社ブランド商品

- ・ 新規商品の拡充
- ・ 海外市場への展開

インレビウム受注高推移

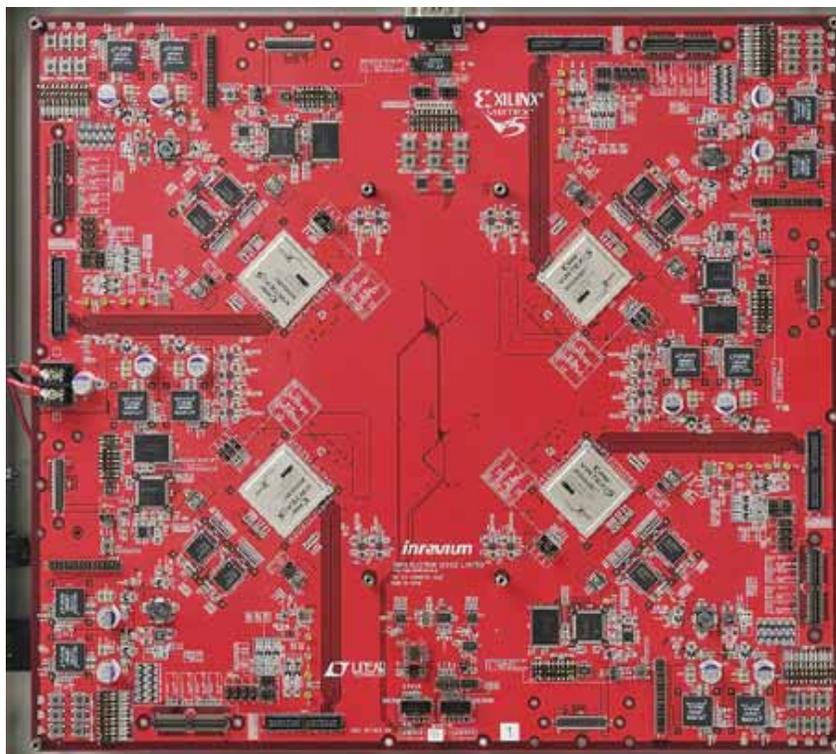
・ 中間受注高 : 13億円 売上高 : 13億円



注) 06/3期以降は、連結売上高を記載しております。

高速演算処理用評価ボード

- ・当社取扱い商品ザイリンクス社製FPGAを4つ並列搭載
- ・大学、研究機関向け高速演算処理システム開発用



< 応用分野 >
宇宙・天体観測、
DNA解析など

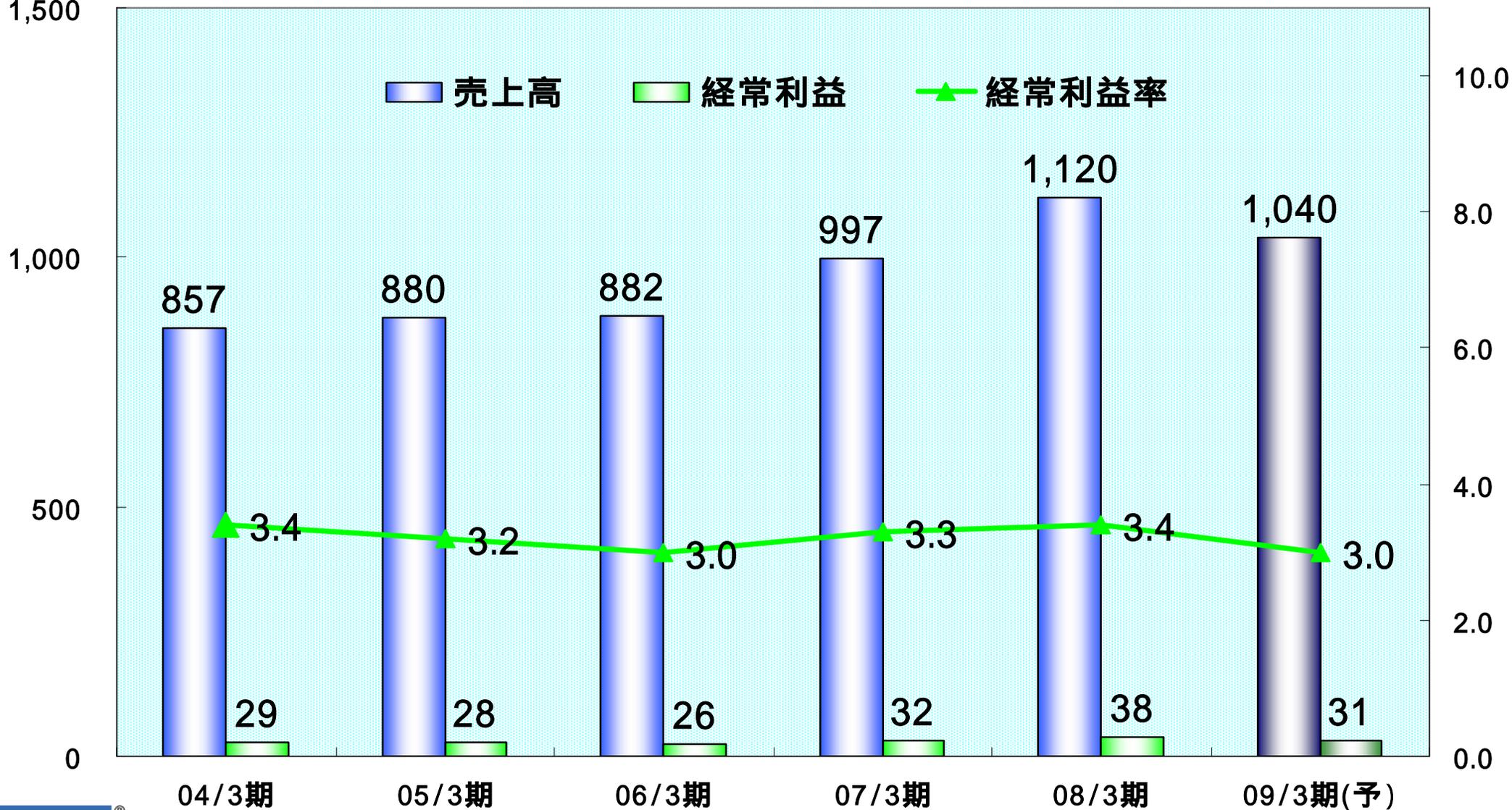
TB-5V-SX95T4-HSC

業績推移・計画

参考資料

(億円)
1,500

(%)



セグメント・品目		主な仕入先名
半導体及び 電子デバイス 事業	半導体製品	
	カスタムIC	富士通エレクトロニクス(株)、ザ・リンクス社
	メモリIC	富士通エレクトロニクス(株)、IDT社、ラムトロンインターナショナル社
	専用IC	コネクサントシステムズ社、フリースケール・セミコンダクタ社、富士通エレクトロニクス(株)、IDT社、ピクセルワークス社、ザ・リンク・セミコンダクター社、インビーム
	汎用IC	リニアテクノロジー社、オン・セミコンダクター社、TI社
	CPU	フリースケール・セミコンダクタ社、富士通エレクトロニクス(株)、TI社
	光学部品	アバゴ・テクノロジー社
	個別素子	オン・セミコンダクター社
	電子部品他	コーセル(株)、(株)デジタル、ダイアロジック社、インビーム
コンピュータシステム 関連事業	コンピュータ・ ネットワーク機器	ブロード社、エミュレックス社、エクストリームネットワークス社、F5ネットワークス社
	ソフトウェア	マイクロソフト社、オラクル社、センセージ社

半導体製品	主な取扱商品	機能
カスタムIC	ASIC PLD	お客様の仕様に応じて作られる固有IC
メモリーIC	DRAM、SRAM フラッシュメモリ	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや読出しのみのものがある
専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用IC
汎用IC	汎用リニアIC(アナログIC) 汎用ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるIC
CPU	マイクロプロセッサ、DSP	電子機器の頭脳、演算機能・制御機能
光学部品	発光ダイオード、フォトカプラ	電気を光に変換して使用する電子部品
個別素子	整流素子、トランジスタ	増幅、整流などの機能を持つ部品

<p>電子部品他</p>		<p>プリント配線基板上にIC、電源、コネクタなどの部品を実装した製品、 機器間を接続するコネクタやケーブル、電源など、電子機器には不可欠な周辺部品。</p>
<p>コンピュータ・ネットワーク機器</p>		<p>インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ) 企業向けネットワークシステム構築機器、 SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ、 SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など。</p>
<p>ソフトウェア</p>		<p>セキュリティ用ログ長期保存・分析ミドルウェア 企業向け産業機器に組み込まれるマイクロソフト社のソフトウェア。</p>

資料取扱い上の注意

このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。